

中华人民共和国

建设工程规划许可证

建字第 33011201800020 号

根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国城乡规划法》和国家有关规定，经审核，本建设工程符合国土空间规划和用途管制要求，颁发此证。

发证机关

日期



建设单位(个人)	杭州中欣晶圆半导体股份有限公司
建设项目名称	半导体大硅片(200mm、300mm)项目
建设位置	大江东江东工业园区
建设规模	178087.53平方米(0米)
附图及附件名称	
建设工程规划许可证附件、附图。 历次发证日期:	
存 5120180219	2018年03月30日 原证
JD3201800033	2020年01月07日 修改

遵守事项

- 一、本证是经自然资源主管部门依法审核，建设工程符合国土空间规划和用途管制要求的法律凭证。
- 二、未取得本证或不按本证规定进行建设的，均属违法行为。
- 三、未经发证机关审核同意，本证的各项规定不得随意变更。
- 四、自然资源主管部门依法有权查验本证，建设单位(个人)有责任提交查验。
- 五、本证所需附图及附件由发证机关依法确定，与本证具有同等法律效力。